

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2020 年 12 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<u>12 月 03 日 20:00-21:00（电话会议）</u> 中银证券 银河基金 招商基金 西部证券自营 雅策投资 嘉实基金 前海开源基金 工银瑞信基金 红土创新基金 中加基金 天弘基金 朱雀投资 国寿资产 钦沐投资 磐厚资产 金鹰基金 中信建投自营 招商局资本 南华基金 宝盈基金 建隆资本 东吴基金 银华基金 泰信基金 益民基金 信达澳银

	中海基金 诺安基金 人寿资产 星石投资 <u>12月17日-12月18日（上海）</u> 混沌投资 平安资管 富国基金 华安基金 GIC 银河基金 太平养老 中欧基金 诺德基金 光大保德信 韶夏资本 JP 摩根资产 浦银安盛基金 东证资管 上投摩根 海富通基金 睿远投资 永赢基金 彤源投资 华泰柏瑞 财通基金 长江养老 <u>12月21日-12月22日（深圳）</u> 招商基金 国信证券 第一创业证券 康佳电子 广东恒健 红土创新基金 大成基金 鹏华基金 博时基金 宝盈基金 融通基金 景顺长城基金 凯丰投资 招商局资本 大岩资本 灏浚投资
--	---

	<u>12月24日-12月25日（北京）</u> 建投华科 嘉实基金 国调基金 国寿养老 建信基金 国新投资 熙诚金睿 银华基金 天弘基金 工银瑞信基金 联想控股 新华基金
时间	12月03日20:00-21:00；12月17日-12月18日； 12月21日-12月22日；12月24日-12月25日
地点	上海、深圳、北京
上市公司接待人员姓名	李 虹 华润微电子首席运营官 彭 庆 华润微电子董事、助理总经理兼财务总监 吴国屹 华润微电子董事会秘书兼战略总监
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司目前的产能利用率？ 目前公司在手订单饱满，产能满载。 问题二：这波行情主要是由需求端还是供给端拉动？ 认为两方面的因素都存在。 需求端方面：一方面由于疫情影响，国产替代加速，另一方面疫情也改变了人们工作生活方式，增加了对电子整机产品的需求，加之国内新基建的启动，这些因素都导致了对芯片需求的增加。 供给端方面：目前八吋线产能有限，短期内难以快速新增产能。 问题三：公司认为本轮景气周期可以持续多久？ 我们认为 2021 年是一个景气的年份，此轮行业景气度预计至少会维持到明年上半年，我们对明年全年行业景气度都持乐观态度。 问题四：公司晶圆代工和自有产品的价格近期有无调整？ 公司针对客户结构、产品线终端应用等情况，已经进行了适度的价格调整，来改善供给紧张的情况。

问题五：疫情会不会影响国内厂商新扩八吋产线的进度，导致产能紧张？

按正常的流程来看，从下设备订单到产线正式运行需要一年的时间。对于去年年底想要扩产的企业来说，疫情确实会对他们造成一定的影响。

问题六：公司在晶圆制造方面，有无产能扩充的计划？

公司无锡八吋线的募投技改项目已经开始建设，预计明年会释放一部分产能，主要和 BCD、MEMS 产品有关；重庆八吋线升级改造项目也将会为明年新增一部分产能。

问题七：公司 12 吋产线进度如何，预计什么时候贡献产能？

公司 12 吋产线 2021 年属于建设期，预计在 2022 年可以实现产能贡献。

问题八：目前公司下游客户的库存水位处在什么水平？

目前行业景气度较高，虽然客户的订单量有所增加，但是我们认为客户的库存仍然处于正常水位。

问题九：公司代工客户会不会有重复下单的情况？会不会对公司造成影响？

在现在产能较为紧张的情况下，存在客户重复下单的可能性，但是一旦公司开始投料生产，客户就必须支付该订单。

目前该情况不会对公司造成影响，后期对客户的库存水位可能会有一定的影响。

问题十：公司上游硅片端有无涨价的趋势？

目前国内硅片价格保持稳定，现阶段公司尚没有看到明显的涨价趋势。

问题十一：公司自有产品占整体营收的占比，明年会不会有较大的变化？

公司自有产品在整体营收中的占比达到 45%左右，公司明年自有产品收入的占比和今年相比，依旧会维持在相对稳定的水平，公司会把握行业的景气度来提升高毛利率

	产品的营收占比，优化公司自有产品结构。 问题十二：请简单介绍一下公司定增项目的规划，后续希望达到怎么样的效果？ 时间节奏是怎么安排的？ 本次定增总募资 50 亿元，其中 38 亿元将投向封测基地，整个封测基地项目建设计划投入 42 亿（不足部分自有资金补足），规划用于功率器件封装、先进封装以及面板级封装。 目前公司功率器件的封装大部分产能依靠外包，随着公司未来成品化率提高和 12 吋产线投产，公司希望提高封测业务的产能，通过封测配套来提高产品业务附加值。 封测基地项目中，功率器件的封装为自身产品做配套，一部分先进封装会进行对外代工，如面板级封装，技术具备差异性和领先性。 时间节奏上，争取 2021 年一季度完成。 问题十三：公司未来折旧的变化趋势？ 公司今年的折旧水平会维持相对稳定。随着公司 IPO 募投项目和八吋线扩产项目的落地，2021 年会增加一部分折旧。2022 年公司计划封测基地开始投产，也会新增有关折旧。 问题十四：公司选择 IDM 模式作为发展路径的原因？ 公司产品聚焦功率半导体和智能传感器，该类产品需要制造工艺和设计能力紧密结合在一起，公司选择 IDM 模式更有利提高产品性能，缩短产品设计研发的时间，提供更好的客制化服务。 问题十五：公司产品终端应用情况如何，未来增长点在哪里？ 公司自有产品排在前列的终端应用有电动自行车、手机及配件、电子照明、家用电器等，后续增长点在变频应用、锂电保护和电池管理应用、新基建相关应用等。 问题十六：公司未来对于自有产品的长期规划？ 目前公司自有产品的营收占公司整体营收的比例约为 45%，公司的长期目标是将自有产品的营收占比提升到 60% 及以上。
--	---

	问题十七：公司 MOSFET 业务未来还有哪些成长空间？ 一、下游的应用需求会增加：随着消费升级，出现了一些新的应用需求，例如手机快充、电动工具、园林工具、动力锂电池、储能、基站电源等。 二、公司产品的成品化率提升，有利于提高产品的毛利率。 三、公司积极拓展新客户，开发新的产品型号，丰富 MOSFET 产品的应用场景。 问题十八：公司 IGBT 业务的进展和未来的增长点？ 今年公司 IGBT 产品收入预计可以突破 1 亿元，前三季度 IGBT 营收较去年同期增长超过 70%，毛利率较去年同期也有显著提升。 公司现有 IGBT 产品主要是以单管的形式进行销售，公司未来除了进一步丰富产品的系列，还持续推进 IGBT 模块化。 问题十九：公司第三代化合物半导体业务的进展？ SiC 方面，公司今年 7 月份在慕尼黑电子展举办了 SiC 二极管的发布会，产品目标应用主要在太阳能逆变器、通讯电源、服务器、储能设备等。预计明年会推出 SiC MOSFET 产品。 GaN 方面，公司利用现有的全产业链优势，正在从衬底材料，器件设计、制造工艺，封装工艺全方位开展硅基氮化镓的研发工作。 问题二十：公司智能传感器业务的发展规划？ 公司智能传感器主要可分为 MEMS 传感器、光电传感器、烟雾报警传感器。 一、MEMS 传感器：公司通过引进海外技术、孵化初创团队等模式，积极推进 MEMS 传感器的自有产品业务。 二、光电传感器：公司是国内领先光电传感器供应商，未来将增加封装的比例，提高光电传感器的成品化率。 三、烟雾报警传感器：国内消防政策的出台，欧洲换购潮，出口业务增加，迎来一定的市场空间。 问题二十一：公司在汽车电子方面的有哪些布局？
--	---

	汽车电子是公司未来重点发力的方向，公司目前在汽车电子方面的应用主要是车载逆变器、车灯照明与驱动、车载充电、车载音响等应用。 公司从外延和内部研发两个方面努力切入汽车电子：公司已通过收购杰群电子 70%的股权切入汽车级电子封装，其他与汽车电子相关的公司也是我们重点关注的目标；同时公司内部也会做相关产品的研发工作，目前已经拥有一定的技术积累，并将积极引进相关领域的专业人才。 问题二十二：公司之前领导人有一些变更，请问公司未来的整体战略规划有无调整？未来产品增长点有哪些？展望十四五公司的战略规划是怎样的？ 公司的愿景是成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商，公司会坚守此战略方向不变。 产品方面，公司会通过内涵式和外延式发展，积极布局第三代化合物半导体、IGBT、MEMS、MCU 等产品，实现功率器件、功率 IC 和智能传感器的全系列产品格局。 公司十四五总体目标是跻身全球功率半导体第一阵营。 问题二十三：公司未来会选择哪一种类型的投资并购标的？随着国内资本市场开放，企业上市机会增大，投资并购难度是否有增加？ 公司未来外延的方向重点关注功率半导体和智能传感器相关的产品公司。 目前科技创新型企业上市机会增大，投资并购机会是减少了一些，企业更愿意独立上市。公司对于投资并购的标的选择有三个方向：有一定规模的上市公司；培育有潜力的初创公司，利用现有制造能力补强产品系列；与海外公司或团队，进行技术引进或合作开发等。 问题二十四：公司内部对人才有哪些激励机制？ 公司对于研发人员采取了多种激励措施：实施市场化的薪酬体系；建立项目跟投、研发项目激励等制度；同时积极推动员工股权激励方案。
日期	2020 年 12 月